



GEMEINSAM MIT MAF GmbH EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT GESTALTEN

Schaffen Sie zusammen mit der MAF GmbH und der HTV-Firmengruppe einzigartige Produkte, die den Anforderungen des Marktes gewachsen und auf Ihre Bedürfnisse optimal abgestimmt sind.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!



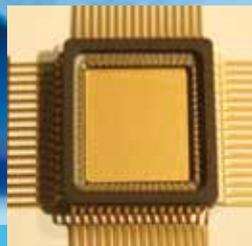
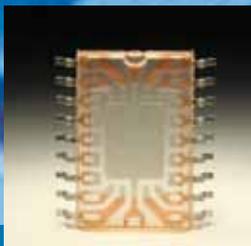
**Microelectronic
Assembly
Frankfurt (Oder) GmbH**

Otto-Hahn-Straße 24
D - 15236 Frankfurt (Oder)
Tel.: + 49-335-3 87 19 63
Email: maf@maf-ffo.de
Web.: www.maf-ffo.de

PACKAGING FÜR ELEKTRONISCHE BAUTEILE UND KOMPONENTEN

Seit 1998 ist die MAF GmbH Spezialist für die Montage mikroelektronischer Schaltkreise und bietet Ihnen einen kompetenten Service auf höchstem Niveau:

- Elektrischer Wafertest
- Wafer-Sägen
- Chip-Bonden & Draht-Bonden
- Häusen / Packaging
- Laserkennzeichnung
- Elektrischer Test & Lead-Inspection
- Konfektionierung: Stange, Tray & Gurt
- Muster-Montage (Keramik, Premold)



Microelectronic
Assembly
Frankfurt (Oder) GmbH

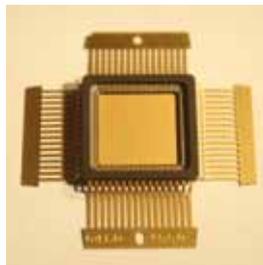
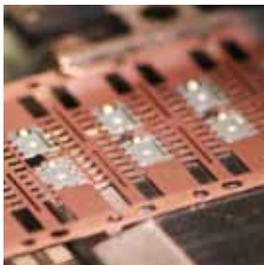




INDIVIDUELLES PACKAGING & BERATUNG

Nennen Sie uns Ihre Problemstellung und wir fertigen Ihnen dazu gerne das passende Wunschgehäuse entsprechend Ihren speziellen Anforderungen. Verwenden Sie z. B. unsere Multi-Die-Technik zum Einsparen von Leiterplattenfläche oder nutzen Sie unsere transparenten Gehäuse für optische Anwendungen.

Zusätzlich bieten wir Ihnen zur Unterstützung Ihrer Produktentwicklung das Bonden von Chips in Keramik- oder Premold-Gehäusen (open cavity) an.



KUNDENSPEZIFISCHE GEHÄUSEENTWICKLUNG

Sie wollen als Alleinstellungsmerkmal ein eigenes Gehäuse oder spezielle Leadframes? Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl und dem passenden Design Ihres neuen Gehäuses.

Über spezielle Leadframes versetzen wir Sie in die Lage, mehrere Chips oder eine ganze Funktionsgruppe in ein einziges Gehäuse integrieren zu können. Auch Verbundgruppen von Bauteilen in einem Gehäuse sind möglich.

OPTIMIERTE FERTIGUNG

Durch den Firmensitz in Frankfurt (Oder) können Sie in kürzester Zeit Muster erhalten und Ihre Entwicklungsprozesse auf Grund kurzer Lieferzeiten und fehlender Sprachbarrieren drastisch verkürzen.

Die MAF GmbH ist damit ein verlässlicher Partner Ihrer Produktentwicklung und ermöglicht Ihnen einen reibungslosen Produktionsanlauf und Herstellungsprozess.

Auch im laufenden Produktionsprozess sind wir immer offen für Ihre Ideen und können immer noch gewünschte Änderungen zeitnah umsetzen.

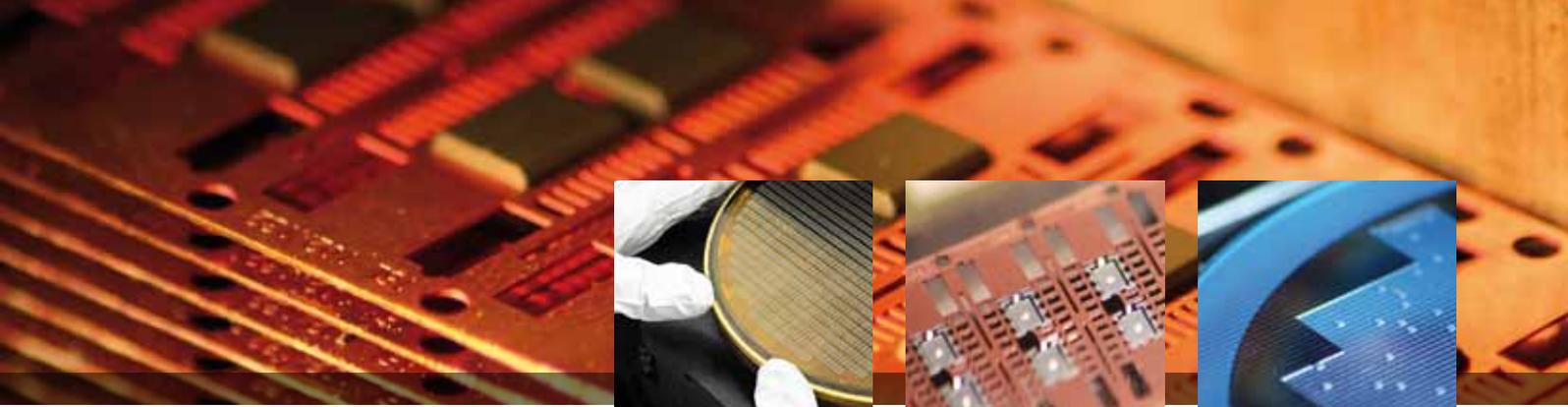
STANDARDGEHÄUSE

Natürlich bietet die MAF GmbH auch die Montage von ICs in unterschiedlichste Standardgehäuseformen an, wie z. B.:

- SOP (JEDEC MS-012 und MS-013)
- SSOP (JEDEC MO-137)
- QFP (JEDEC MS-022)
- FOQ (JEDEC MO-220)
- FOD (JEDEC MO-229)

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

Waffle-Pack für Ihre Chips, Laser-Kennzeichnung der Bauteile und viele weitere Dienstleistungen gehören selbstverständlich auch zu unserem Angebotsspektrum.



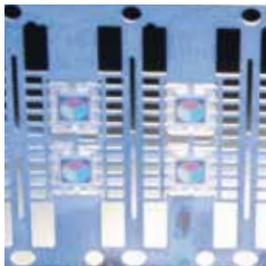
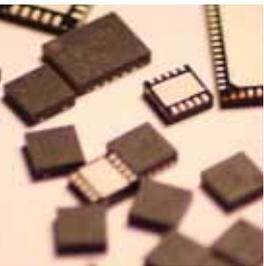
DYNAMISCHES FIRMENNETZWERK

Die Spezialisten der HTV-Firmengruppe sind kurzfristig jederzeit in der Lage, Lösungen zu Problemen aus den Bereichen Messtechnik, Analytik und Langzeitkonservierung elektronischer Bauteile zu erarbeiten.

QUALITÄT

Seit 1998 ist die MAF GmbH Spezialist für die Montage mikroelektronischer Schaltkreise. Aus dieser langen Erfahrung hat sich ein hoher Qualitätsstandard etabliert.

Die Prozesse der MAF GmbH sind nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und alle Prozesse werden streng überwacht.



MAF DIENSTLEISTUNGEN UND ARBEITSSCHRITTE

ELEKTRISCHER TEST UND BAUTEILQUALIFIKATION

Über die HTV-Firmengruppe können Wafer und auch fertig gehäuste elektronische Bauteile elektrisch getestet werden.

Darüber hinaus stehen Ihnen vielfältige Verfahren für die Analyse und Qualifizierung Ihrer elektronischen Bauteile zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die Erstellung von Schliff- und Röntgenbildern, Burn-In und die Langzeitlagerung elektronischer Bauteile oder ganzer Baugruppen.

